

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2025-001

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司不动产解除抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、抵押情况概述

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“兴业银行”）申请不超过2.5亿元的综合授信额度，期限为一年。赛积国际以其自有的坐落于北京经济技术开发区科创十三街1号院1至5层101等4套的房产为其向兴业银行申请的综合授信额度提供抵押担保。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司不动产抵押的公告》（公告编号：2023-154）。

二、解除抵押情况

2024年12月26日，赛积国际已还清兴业银行贷款本金及利息。2025年1月15日，抵押人（赛积国际）与抵押权人（兴业银行）在北京经济技术开发区不动产登记中心办理完毕了抵押权注销登记手续，该笔不动产抵押正式解除。

本次解除不动产抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025年1月15日